

中信建投证券股份有限公司

关于

联芸科技（杭州）股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

二〇二六年五月

保荐人及保荐代表人声明

中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人郭泽原、包红星已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义.....	3
一、发行人基本情况	4
二、发行人本次发行情况	10
三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式	13
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明	16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项	17
六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明	18
七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程	18
八、持续督导期间的工作安排	20
九、保荐人关于本项目的推荐结论	21

释 义

在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

保荐人、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
联芸科技、发行人、公司	指	联芸科技（杭州）股份有限公司
发行方案	指	联芸科技（杭州）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票方案
本次发行、本次向特定对象发行、本次向特定对象发行股票	指	联芸科技（杭州）股份有限公司2026年度向特定对象发行A股股票的行为
A股	指	经中国证监会审批向境内投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币认购和交易、每股面值为人民币1.00元的普通股
定价基准日	指	计算发行底价的基准日
股东会	指	联芸科技（杭州）股份有限公司股东会
董事会	指	联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
报告期	指	2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-3月
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日及2026年3月31日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
中信建投基金	指	中信建投基金管理有限公司，系保荐人全资子公司
中信建投投资	指	中信建投投资有限公司，系保荐人全资子公司

注：本上市保荐书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。

一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称	联芸科技（杭州）股份有限公司
英文名称	Maxio Technology (Hangzhou) Co., Ltd.
成立时间	2014年11月7日
法定代表人	李国阳
注册资本	460,000,000元
总股本	460,000,000股
股票上市地	上海证券交易所
上市板块	科创板
股票简称	联芸科技
股票代码	688449
上市时间	2024年11月29日
公司住所	浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号C楼C1-604室
邮政编码	310059
电话号码	0571-85892516
传真号码	0571-85892517
公司网址	www.maxio-tech.com
电子邮箱	ir@maxio-tech.com
经营范围	技术开发、技术服务、成果转让：集成电路、计算机软件；生产：计算机软件产品；销售自产产品；批发：电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（涉及许可证的凭证经营，国家禁止和限制的除外）（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）。

（二）发行人主营业务

联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具有市场竞争力的大规模集成电路芯片及解决方案。

在固态存储领域，公司自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产

业化，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。同时，公司基于自主的芯片设计研发平台，已形成多款 AIoT 信号处理及传输芯片的产品布局，并实现量产应用。公司开发的上述芯片可广泛应用于消费电子、工业控制、数据通信、智能物联等领域。

未来，公司将始终围绕数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片两大领域的关键核心技术持续创新。在数据存储主控芯片领域，公司将积极参与固态存储产业链构建，持续提升固态硬盘主控芯片的核心竞争力和市场占有率，并实现嵌入式存储主控芯片的技术及市场突破，成为存储市场主控芯片领域的核心参与者之一；在 AIoT 信号处理及传输芯片领域，公司将重点开拓智能家居、汽车电子等领域的行业应用，加大研发投入、完善产品布局，提升产品市场竞争力。公司致力于发展成为具备行业竞争力的集成电路设计企业，通过持续创新，提供卓越的产品和服务，用芯片促进科技进步，为社会创造价值。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2026年 3月31日	2025年 12月31日	2024年 12月31日	2023年 12月31日
资产总额	244,978.91	235,497.08	208,647.91	85,529.27
负债总额	52,238.68	44,927.57	37,663.09	33,671.52
归属于母公司所有者权益	192,740.23	190,569.51	170,984.82	51,857.75
股东权益合计	192,740.23	190,569.51	170,984.82	51,857.75

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
营业收入	35,527.51	132,712.94	117,378.39	103,373.62
营业利润	828.65	14,226.00	11,821.37	5,318.59
利润总额	886.03	14,215.85	11,805.86	5,222.96
净利润	886.03	14,215.85	11,805.86	5,222.96
归属于母公司所有者的净利润	886.03	14,215.85	11,805.86	5,222.96

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2026年1-3月	2025年度	2024年度	2023年度
经营活动产生的现金流量净额	8,953.34	15,533.55	-2,256.82	17,289.62
投资活动产生的现金流量净额	-40,885.12	-15,388.73	-3,927.80	-7,134.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,751.20	-364.14	104,406.39	2,760.16
现金及现金等价物净增加额	-30,426.21	-419.68	98,279.91	12,940.41

4、主要财务指标

项目	2026年 3月31日/ 2026年1-3月	2025年 12月31日/ 2025年度	2024年 12月31日/ 2024年度	2023年 12月31日/ 2023年度
基本每股收益（元/股）	0.02	0.31	0.32	0.15
稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	不适用	不适用
毛利率（%）	51.46	51.43	47.47	45.66
每股净资产（元/股）	4.19	4.14	3.72	1.44

注：1、基本每股收益、稀释每股收益系按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算；2、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入。

（四）发行人存在的主要风险

1、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（1）业务经营风险

①产品研发风险

集成电路设计行业具有竞争激烈、研发投入大、不确定性较高、产品更新换代较快的特点。报告期内，公司研发费用分别为 37,971.23 万元、42,518.48 万元、50,277.02 万元和 14,693.20 万元，占营业收入的比例分别为 36.73%、36.22%、37.88%和 41.36%，占比较高且金额增长较快。数据存储主控芯片涉及领域较多，且每款接口协议的升级迭代速度较快，目前公司数据存储主控芯片已经覆盖 UFS 嵌入式存储和 SSD 主控芯片，覆盖 UFS 3.1、SATA、PCIe Gen3、PCIe Gen4、PCIe Gen5 等接口领域、覆盖消费级、工业级、企业级等应用领域，并计划通过本次发行研发新一代数据存储主控芯片产品。在当前硬件迭代周期持续缩短的背

景下，若公司未来未能及时推出适配新技术、新标准的芯片产品，随着行业终端产品全面升级至新标准，公司现有产品虽仍具备一定市场需求，但随着下游应用逐步向新技术、新标准迁移，其销售收入增长空间或将受到制约，市场竞争力亦可能逐步弱化，进而对公司经营业绩的增长性产生不利影响。

②客户集中度较高的风险

报告期内，公司的芯片产品主要采用直销模式向模组厂商或终端设备厂商销售产品，受已开发完成的客户持续放量、产品下游应用领域等因素影响，公司存在客户集中度较高的情况。公司的经营业绩与下游模组厂商、终端设备厂商的经营情况相关性较高，如未来该等厂商的市场份额下降或竞争地位发生重大变动，或公司与该等厂商的合作关系发生变化，公司将面临订单减少或流失等风险，进而对公司的经营业绩造成不利影响。

③供应商集中风险

公司为典型的采用 Fabless 经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。由于集成电路行业的特殊性，晶圆生产制造环节对技术及资金规模要求较高且市场集中度很高，能够满足公司业务需求的具备先进工艺的厂商数量更少。行业内，众多集成电路设计企业出于工艺稳定性和批量采购成本优势等方面的考虑，往往仅选择个别晶圆厂和封测厂进行合作。

报告期内，公司向前五大供应商的采购金额分别为 36,452.18 万元、68,080.34 万元、93,619.35 万元以及 22,207.20 万元，占各年度采购总额的比例分别为 93.30%、92.06%、93.26% 以及 94.51%，供应商较为集中。由于主要供应商集中，如果供应商发展经营不善或与公司合作受限，公司需要短期内找到合适的替代供应商，否则将影响产品的稳定生产。同时，如果未来国际出口管制和贸易摩擦加剧，使得公司相关原材料进口受到限制，影响订单正常履行，也将会对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

(2) 财务风险

①存货跌价风险

报告期各期末，公司的存货账面价值分别为 18,259.12 万元、30,894.10 万元、

57,651.85 万元以及 59,076.44 万元，占流动资产的比例分别为 24.88%、15.90%、27.03%以及 31.50%。若未来市场环境发生变化、竞争加剧或技术更新、下游客户采购政策或经营情况发生重大变化导致存货积压，则公司存货可能面临跌价风险，从而对公司经营业绩产生不利影响。

②应收账款回收风险

报告期各期末，公司的应收账款账面余额分别为 27,520.93 万元、45,349.76 万元、31,562.65 万元以及 30,992.52 万元，占当期营业收入的比例分别为 26.62%、38.64%、23.78%以及 87.24%。随着公司业务规模的扩大，应收账款可能继续增加，如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化或个别客户经营状况发生困难，公司存在因应收账款难以收回而发生坏账的风险，进而对公司未来业绩、现金流量造成不利影响。

（3）行业及宏观环境风险

①行业竞争风险

目前，数据存储的重要介质—NAND 闪存颗粒主要掌握在三星、SK 海力士、美光等海外厂商中，上述厂商依靠 NAND 闪存颗粒的先发优势、资金实力，可以自主生产数据存储主控芯片，数据存储主控芯片的主要市场份额依旧被海外芯片厂商所垄断，在企业级固态硬盘主控芯片和嵌入式存储主控芯片领域，海外芯片厂商的优势更为明显。同时，数据存储主控芯片在终端产品以及与 NAND 闪存颗粒上的迭代适配需要一定的时间，品牌客户或系统厂商对于芯片供应商的需求存在一定的惯性和时间要求，只有在供应商完成芯片的迭代适配并能稳定供货时，品牌客户才会进行大规模的供应商切换，国内数据存储主控芯片产品的生态系统还在建立中。公司虽然在国内数据存储主控芯片方面市场优势突出，也取得了一定的全球市场影响力，但相较海外芯片厂商还处于劣势地位。如果公司对未来市场动态和行业发展趋势出现误判，开发的芯片产品不符合市场需求或错失市场窗口，将会出现公司行业地位和市场份额受到冲击的情况。

②国际出口管制和贸易摩擦风险

近年来，国际贸易中部分国家针对半导体设备领域颁布了一系列对中国的出口管制政策，同时，陆续将多家中国半导体企业纳入“实体清单”（Entity List）

和“未经核实清单”（Unverified List），限制其采购受《出口管制条例》管辖的物品。

随着全球主要经济体经济增速持续放缓，贸易保护主义及国际经贸摩擦的风险仍将存在，不能排除国际贸易政策未来变化会对国内芯片设计企业带来一定的限制和不利影响，从而影响本土半导体产业链完整、持续、稳定的发展。随着相关事态的发展，贸易政策发生不利变化，公司可能面临相关订单减少的局面，进而对公司的生产经营及财务状况造成重大不利影响。

2、可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素

（1）审批风险

本次发行尚需满足多项条件方可完成，包括但不限于上海证券交易所审核通过并获得中国证监会注册等。本次发行能否获得上述审核批准或注册，以及获得相关审核批准或注册的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

（2）发行风险

本次发行的发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%，且最终由公司根据竞价结果与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。本次发行的发行结果将受到宏观经济和行业发展情况、证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度等多种内外部因素的影响。因此，本次发行存在发行募集资金不足甚至无法成功实施的风险。

（3）股票价格波动风险

本次发行后，公司的股票价格不仅受到财务状况、经营业绩和未来发展前景等内在因素的影响，还会受到国内外政治经济局势、资金供求关系、投资者心理变化等多种外部因素的影响。公司股票价格可能产生较大扰动并背离投资价值，从而使投资者面临投资损失的风险。因此，投资者应清醒认知资本市场投资收益与风险并存的特点，充分了解股票市场的投资风险及公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

3、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

(1) 募集资金投资项目实施风险

公司已结合当前行业发展情况、公司发展战略等因素对募集资金投资项目进行了审慎、充分的调研、论证和可行性分析，但本次募集资金投资项目投入较大、实施期较长，期间若宏观政策环境、行业竞争情况、技术水平、下游需求等因素发生不利变化可能会对募集资金投资项目的实施产生较大影响，导致募投项目的实施效果不及预期，进而对公司业绩产生不利影响。

(2) 本次发行股票摊薄即期回报的风险

本次发行完成后，公司总股本和净资产规模将相应增加，虽然本次募集资金到位后，公司将高效利用募集资金以提升公司技术能力和长期盈利能力，但受国家宏观经济、行业发展情况、募投项目建设期等因素影响，短期内公司净利润增长幅度可能会低于净资产和总股本的增长幅度，因此本次发行后公司股东即期回报存在被摊薄的风险。

二、发行人本次发行情况

(一) 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元。

(二) 发行方式和发行时间

本次发行将全部采用向特定对象发行股票的方式进行，公司将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后，在规定的有效期内择机发行。

(三) 发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过 35 名（含）符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公

司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东会授权，在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，根据竞价情况与保荐人（主承销商）协商确定。若发行时国家法律、法规或规范性文件对发行对象另有规定的，从其规定。所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%（定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量）。若公司股票在该二十个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行底价将作相应调整。调整方式如下：

派发现金股利： $P_1=P_0-D$

送股或转增股本： $P_1=P_0/(1+N)$

两项同时进行： $P_1=(P_0-D)/(1+N)$

其中， P_0 为调整前的发行底价， D 为每股派发现金股利， N 为每股送股或转增股本数， P_1 为调整后的发行底价。

最终发行价格将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或董事会授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定，但不低于前述发行底价。

（五）发行数量

本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 10%，即不超过 46,000,000 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行获得上交所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会及其授权人士根据股东会授权、中国证监会及上交所相关规定、中国证监会注册的发行数量上限与保荐人（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或者因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化，本次向特定对象发行的股票数量上限将作相应调整。

若本次向特定对象发行的股份总数因监管政策变化或根据发行注册文件的要求予以变化或调减的，则本次向特定对象发行的股份总数及募集资金总额届时将相应变化或调减。

（六）限售期

本次发行完成后，发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次发行完成后至限售期届满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上交所等有关规定执行。

（七）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 206,167.60 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1	面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目	214,500.96	166,167.60
1.1	企业级PCIe Gen6 SSD主控芯片	44,403.40	44,403.40

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用本次募集资金投资金额
1.2	企业级PCIe Gen7 SSD主控芯片	89,820.06	41,486.70
1.3	消费级PCIe Gen6 SSD主控芯片	46,135.32	46,135.32
1.4	UFS 5.0嵌入式存储主控芯片	34,142.19	34,142.19
2	补充流动资金	40,000.00	40,000.00
	合计	254,500.96	206,167.60

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整，募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自有或自筹资金解决。

（八）本次发行前滚存未分配利润安排

本次向特定对象发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。

（九）股票上市地点

本次向特定对象发行的股票将申请在上交所科创板上市交易。

（十）本次发行决议的有效期限

本次向特定对象发行股票相关决议的有效期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地址、电话和其他通讯方式

（一）本次证券发行上市的保荐代表人

中信建投证券指定郭泽原、包红星担任本次联芸科技（杭州）股份有限公司向特定对象发行股票的保荐代表人。

上述两位保荐代表人的执业情况如下：

郭泽原先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业

务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板 IPO 项目、谱尼测试集团股份有限公司创业板 IPO 项目、首创证券股份有限公司主板 IPO 项目、中信证券发行股份购买广州证券独立财务顾问项目等。目前无作为保荐代表人尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

包红星先生：保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板 IPO 项目、陕西华秦科技实业股份有限公司科创板 IPO 项目、中铁高铁电气装备股份有限公司科创板 IPO 项目、上海数据港股份有限公司主板 IPO 项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司科创板 IPO 项目、湖北戈碧迦光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、北京中航泰达环保科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌项目、天壕环境股份有限公司向不特定对象公开发行可转债项目、引力传媒股份有限公司非公开发行股票项目、天康生物股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市奋达科技股份有限公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目等。目前无作为保荐代表人尽职推荐的项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）本次证券发行上市项目协办人

本次证券发行上市项目的协办人为林云汉，其保荐业务执行情况如下：

林云汉先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：杭州云深处科技股份有限公司科创板 IPO 项目（在审）、联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板 IPO 项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）本次证券发行上市项目组其他成员

本次证券发行上市项目组其他成员包括马昊、程凯琪、陈嘉宁、张静、侯森。

马昊先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、力高新能源技术股份有限公司创业板 IPO 项目（在审）、北京市九州风神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；北京市九州风神科技股份有限公司新三板挂牌项目、北京北琪医疗科技股份有限公司新三板挂牌项目、北京杰西慧中科技股份有限公司新三板挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

程凯琪先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：北京市九州风神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；山东英轩实业股份有限公司新三板挂牌项目、北京北琪医疗科技股份有限公司新三板挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

陈嘉宁先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级经理，曾主持或参与的项目有：辽宁春光制药装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目、北京市九州风神科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目（在审）；北京市九州风神科技股份有限公司新三板挂牌项目、山东英轩实业股份有限公司新三板挂牌项目、北京杰西慧中科技股份有限公司新三板挂牌项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

张静女士：保荐代表人，具有注册会计师资格、香港证券与期货从业员资格，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、七星电子股份有限公司 IPO 项目、东方网力股份有限公司创业板 IPO 项目、七星电子股份有限公司非公开发行项目、西南证券股份有限公司非公开发行项目、吉林利源

精制股份有限公司非公开发行项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

侯森先生：注册会计师，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：联芸科技（杭州）股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创板 IPO 项目、欣旺达电子股份有限公司公开发行可转债项目、长沙岱勒新材料科技股份有限公司公开发行可转债项目、湖北东贝机电集团股份有限公司非公开发行股票项目、北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票项目等。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐人（主承销商）：	中信建投证券股份有限公司
联系地址：	北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦11层
邮编：	100010
联系电话：	010-56052591
传真：	010-56160130

四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）截至 2026 年 3 月 31 日，保荐人自营业务持有发行人 15,808 股股票，中信建投基金持有发行人 6,671,002 股股票，中信建投投资持有发行人 4,000,000 股股票。中信建投证券及其子公司合计持有发行人 10,686,810 股股票，占发行人发行前总股本的 2.32%。中信建投证券买卖发行人的股票基于其已公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和股票投资价值的分析和判断，出于合理安排和资金需求筹划而进行，从未知悉、探知、获取或利用任何相关内幕信息，也从未有任何人员向中信建投证券泄漏相关信息或建议中信建投证券买卖发行人的股票。中信建投证券已经制定并执行信息隔离管理制度，在存在利益冲突的业务之间设置了隔离墙，符合中国证券业协会《证券公司信息隔离墙制度指引》等规定。中信建投证券持有发行人股票履行了《证券发行上市保荐业务管理办法》第四十一条规定的利益冲突审查程序。

除上述情况外，不存在其他保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方

持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况；保荐人已建立了有效的信息隔离墙管理制度，保荐人及其子公司持有发行人股份的情形不影响保荐人及保荐代表人公正履行保荐职责；

（二）截至本上市保荐书出具日，不存在发行人或其实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员，拥有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况；

（四）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）截至本上市保荐书出具日，不存在保荐人与发行人之间的其他关联关系。

五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项

保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，中信建投证券作出以下承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规和中国证监会及上交所有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及本保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

(六) 保证上市保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(七) 保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

(八) 自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

(九) 中国证监会、上交所规定的其他事项。

中信建投证券承诺，将遵守法律、行政法规和中国证监会、上交所对推荐证券上市的规定，自愿接受上交所的自律监管。

六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明

发行人于 2026 年 4 月 9 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的预案及相关议案。

发行人于 2026 年 5 月 11 日召开了 2025 年年度股东会，审议通过了关于本次向特定对象发行股票的预案及相关议案。

本次向特定对象发行股票方案尚需经过上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

经核查，发行人已就本次向特定对象发行股票履行了《公司法》《证券法》等有关法律、法规及中国证监会规定以及上交所的有关业务规则的决策程序。

七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程

(一) 保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由和依据

联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。目前，公司已构建起 SoC 芯片架构设计、算法设计、数字 IP 设计、模拟 IP 设计、中后端设计、封测设计、系统方案开发等全流程的芯片研

发及产业化平台。公司始终坚持核心技术自主研发和迭代创新，不断推出具有市场竞争力的大规模集成电路芯片及解决方案。

公司自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产业化，已发展成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数据存储主控芯片核心技术的企业之一。同时，公司基于自主的芯片设计研发平台，已形成多款 AIoT 信号处理及传输芯片的产品布局，并实现量产应用。目前公司数据存储主控芯片已经形成覆盖 SATA、PCIe Gen3/Gen4/Gen5 SSD 固态硬盘主控芯片以及 UFS 嵌入式存储主控芯片的产品布局。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司从事的集成电路设计为战略性新兴产业，具体分类为：1 新一代信息技术产业-1.3 新兴软件和新型信息技术服务-1.3.4 新型信息技术服务（6520 集成电路设计），符合科创板行业领域要求；根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》，公司属于新一代信息技术领域企业，符合科创板行业领域要求。

集成电路行业是国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，是培育和发展新兴产业、推动信息化与工业化深度融合的核心和基础。政府自 2000 年以来将集成电路行业确定为国民经济支柱性行业之一，并先后出台了一系列针对集成电路行业的产业政策，支持集成电路相关的税收减免、研发创新、人才引用、市场应用等方面，推动了行业的迅速发展。《“十五五”规划纲要》明确提出“聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，采取超常规措施，全链条推动集成电路……等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破”。公司所在行业属于高新技术产业和战略性新兴产业，公司主营业务符合板块定位及国家产业政策。

公司本次募集资金投资项目包括“面向数据中心与智能终端的新一代数据存储主控芯片系列产品研发项目”和补充流动资金，将主要用于巩固公司在数据存储主控芯片领域的核心业务，丰富公司技术储备，提升公司科技创新水平，持续丰富和优化产品线，提升突破关键核心技术的基础和潜力。公司本次募集资金主要投向科技创新领域，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求，服务于国家创新驱动发展战略及国家经济高质量发展战略，本次发行募集资金用途符合国家相关的产业政策。

(二) 保荐人的核查内容和核查过程

保荐人主要履行了如下核查程序：

1、查阅《战略性新兴产业分类（2018）》《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》等相关规定对公司所在行业是否符合国家产业政策进行分析；

2、查阅公司定期报告、行业研究报告、同行业可比上市公司公开信息，并与公司相关负责人进行访谈，了解公司经营、本次募投项目情况及未来发展规划。

八、持续督导期间的工作安排

事项	安排
(一) 持续督导事项	在本次发行上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导
1、督导发行人有效执行并完善防止实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	根据有关上市保荐制度的规定精神，协助发行人进一步完善、执行有关制度，保证发行人资产完整和持续经营能力
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	根据有关上市保荐制度的规定，协助发行人进一步完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况及履行信息披露义务的情况
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人的关联交易按照《公司章程》《关联交易管理制度》等规定执行，严格履行信息披露制度，及时公告关联交易事项，保荐人按照有关规定对关联交易发表意见
4、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	督导发行人严格按照投资计划使用募集资金；定期跟踪了解项目进展情况，通过列席发行人董事会、股东会等方式，对发行人募集资金项目的实施、变更发表意见
5、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	督导发行人遵守《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所关于对外担保的相关规定
6、中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作	根据中国证监会、上海证券交易所有关规定以及保荐协议约定的其他工作，保荐人将持续督导发行人规范运作
(二) 保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	提醒并督导发行人按照约定及时通报有关信息；根据有关规定，对发行人违法违规行为事项发表公开声明
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	对中介机构出具的专业意见存有疑义的，中介机构应做出解释或出具依据
(四) 其他安排	本保荐人将严格按照中国证监会、上海证券交易所的各项要求对发行人实施持续督导

九、保荐人关于本项目的推荐结论

本次发行上市申请符合法律法规和中国证监会及上交所的相关规定。保荐人已按照法律法规和中国证监会及上交所相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序并具备相应的保荐工作底稿支持。

保荐人认为：本次向特定对象发行上市符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及上交所有关规定；中信建投证券同意作为联芸科技本次向特定对象发行上市的保荐人，并承担保荐人的相应责任。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中信建投证券股份有限公司关于联芸科技(杭州)股份有限公司向特定对象发行股票之上市保荐书》之签字盖章页)

项目协办人签名: 林云汉

林云汉

保荐代表人签名: 郭泽原 包红星

郭泽原

包红星

内核负责人签名: 徐子桐

徐子桐

保荐业务负责人签名: 刘乃生

刘乃生

法定代表人/董事长签名: 刘成

刘成

